

证券代码：300852

证券简称：四会富仕



**四会富仕电子科技股份有限公司**

**2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案**

二〇二六年四月

## 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册。

## 重大事项提示

1、本次向特定对象发行股票方案已经公司 2026 年第三届独立董事第二次专门会议、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议并通过，尚需获得公司股东大会的批准、深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行股票的价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册批复后，由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行股票的数量不超过 48,156,349 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。

5、本次向特定对象发行股票募集资金总额（已扣除财务性投资）为不超过 95,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）。

在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，募集资金不足部分由公司自筹解决。

6、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、本次向特定对象发行股票未触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

8、本次向特定对象发行完成前，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

9、本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。在该锁定期内，发行对象取得的本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守前述股份锁定安排。

若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的锁定期的规定进行修订或有最新监管意见的，则按照修订后的规定或最新监管意见确定本次向特定对象发行股票的锁定期。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

10、根据中国证监会《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请详见本预案“第五节 公司利润分配政策和执行情况”。

11、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本预案“第六节 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”的相关内容。

公司特别提醒投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

12、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次股票发行相关的风险说明”，注意投资风险。

13、本次向特定对象发行股票方案最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定，尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

# 目录

发行人声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目录 .....	5
释义 .....	7
<b>第一节 本次向特定对象发行股票概要 .....</b>	<b>9</b>
一、发行人基本情况 .....	9
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 .....	10
三、发行对象及其与公司的关系 .....	14
四、本次发行方案概要 .....	15
五、募集资金投向 .....	17
六、本次发行决议有效期 .....	18
七、本次发行是否构成关联交易 .....	18
八、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .....	18
九、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 .....	18
十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序 .....	19
<b>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....</b>	<b>20</b>
一、本次募集资金使用计划 .....	20
二、募集资金投资项目的具体情况 .....	20
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>	<b>26</b>
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 .....	26
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....	27
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 .....	27
四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 .....	28
五、本次发行对公司负债情况的影响 .....	28
<b>第四节 本次股票发行相关的风险说明 .....</b>	<b>28</b>

一、与本次向特定对象发行的相关风险 .....	28
二、募集资金运用的风险 .....	29
三、行业及市场风险 .....	30
四、业务经营风险 .....	31
<b>第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况 .....</b>	<b>32</b>
一、公司现行的利润分配政策 .....	32
二、公司最近三年现金分红情况 .....	35
三、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 .....	35
<b>第六节 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及 相关主体承诺 .....</b>	<b>38</b>
一、本次发行对公司主要财务指标的影响 .....	38
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示 .....	40
三、本次发行的必要性和合理性 .....	40
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 .....	40
五、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施 .....	43
六、相关主体关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 .....	44

## 释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通术语		
四会富仕/发行人/公司/本公司	指	四会富仕电子科技有限公司
四会明诚	指	四会市明诚贸易有限公司，发行人控股股东
天诚同创	指	四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
一鸣投资	指	四会市一鸣投资有限公司，发行人股东
本次向特定对象发行/本次发行	指	四会富仕电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的行为
预案/本预案	指	《四会富仕电子科技有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》
定价基准日	指	公司本次向特定对象发行A股股票发行期的首日
发行底价	指	本次向特定对象发行定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的80%
《公司章程》	指	现行有效的《四会富仕电子科技有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语		
印制电路板/PCB	指	英文全称“Printed Circuit Board”，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”
高多层板	指	指使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合的PCB
双面板	指	指在基板两面形成导体图案的PCB
挠性板	指	指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，并具有一定弯曲性的印制电路板，又称“软板”、“柔性板”
刚挠结合板	指	刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求，又称“软硬结合板”
HDI板	指	HDI是High Density Interconnect 的缩写，即高密度互连技术。HDI是印制电路板技术的一种，是随着电子技术更趋精密化发展演变出来用于制作高精密度电路板的一种方法，可实现高密度布线，一般采用积层法制造。HDI板通常指孔径在0.15mm(6mil)以下(大部分为盲孔)、孔环之孔径在0.25mm(10mil)以下的微孔，接点密度在130点/平方英寸以上，布线密度在117英寸/平方英寸以上的多层印制电路板
金属基板	指	指由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板
覆铜板/基板/基材	指	指Copper Clad Laminate，简称CCL，为制造PCB的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基材）和柔性材料两大类

半固化片	指	又称为“PP片”或“树脂片”，是制作多层板的主要材料，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型。制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料
电镀	指	指一种电离子沉积过程，利用电极通过电流，使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸
EMS企业	指	电子制造服务商（Electronics Manufacturing Service），指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商
Prismark	指	指美国Prismark Partners LLC，是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在PCB行业有较大影响力
光模块	指	又称光收发一体模块，是实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光器件、功能电路和光接口等构成
盲孔	指	将PCB任意相邻层以电镀孔连接的称为盲孔
IDC	指	国际数据集团（IDG）的全资子公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商

本预案中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

## 第一节 本次向特定对象发行股票概要

### 一、发行人基本情况

公司名称	四会富仕电子科技股份有限公司
英文名称	Sihui Fuji Electronics Technology Co.,Ltd.
成立日期	2009年8月28日
注册资本	16,052.1165 万元人民币
股票上市地	深圳证券交易所
A 股股票简称	四会富仕
A 股股票代码	300852.SZ
法定代表人	刘天明
注册地址	四会市下茆镇龙湾村西鸦崑
注册地址的邮政编码	526200
办公地址	四会市下茆镇四会电子产业园 2 号
办公地址的邮政编码	526200
联系电话	0758-3106018
联系传真	0758-3527308
公司网址	<a href="http://www.fujipcb.cn/">http://www.fujipcb.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:stock@fujipcb.cn">stock@fujipcb.cn</a>
经营范围	研发、制造、销售：双面、多层、刚挠结合、金属基、高频、HDI、元件嵌入式等电路板；电路板设计；电路板表面元件贴片、封装；自动化产品的研发、生产、销售；新型材料的研发、生产、销售；国内贸易；货物的进出口、技术进出口。（以上项目不含工商登记前置审批事项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

### （一）本次向特定对象发行股票的背景

#### 1、国家产业政策持续出台，科技创新倒逼 PCB 产业发展

印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是：（1）为电路中各种元器件提供机械支撑；（2）使各种电子器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用；（3）用标记符号将所安装的各元器件标注出来，便于插装、检查及调试。PCB 可以实现电子元器件之间的相互连接，起中继传输的作用，是电子元器件的支撑体，是电子产品的关键电子互连件。

《“十四五”规划纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策文件明确提出要培育人工智能等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，并加快构建完善的国内电子信息产业链生态。这些政策为 PCB 产业提供了发展机遇，鼓励企业聚焦高端技术研发，突破国外技术垄断。

2025 年 10 月政府出台《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“十五五规划”），“十五五规划”提出加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；建设现代化产业体系，优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，巩固壮大实体经济根基；推动科技创新和产业创新深度融合。“十五五规划”明确了科技自立自强的重要性，对于 PCB 行业下游应用领域，“十五五规划”提出加快新能源、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，加快人工智能等数智技术创新，并推动脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业成为新的经济增长点。

PCB 作为“电子产品之母”，广泛应用于集成电路、新能源、航空航天、低空经济、人工智能、移动通信等战略性新兴产业和未来产业集群，提升 PCB 产业创新体系的整体效能，对于新质生产力产业落地具有关键支撑作用。

## **2、PCB 市场空间广阔，下游需求旺盛**

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。2023 年，全球 PCB 产值为 695.17 亿美元。2024 年，受益于 AI 服务器及相关高速网络基础设施推动、智能手机市场复苏等，全球 PCB 产值达到 735.65 亿美元，同比增长 5.8%。自 2006 年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产地区，PCB 的产量和产值均居世界第一。2023 年，中国大陆 PCB 行业产值为 377.94 亿美元。2024 年，PCB 行业迎来结构性复苏，中国大陆 PCB 行业产值为 412.13 亿美元，较上年增长约 9%。中国大陆作为全球 PCB 行业的最大生产地区，占全球 PCB 总产值的比例已由 2000 年的 8.1% 上升至 2024 年的 56.00%。

未来在低碳化、智能化等因素的驱动下，5G 通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车、人工智能等 PCB 下游应用行业预期将蓬勃发展，下游应用行业的蓬勃发展将带动 PCB 需求的持续增长。根据 Prismark 的最新预测，未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长，2024 年至 2029 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 8.2%，至 2029 年预计全球 PCB 市场将达到 10,925.80 亿美元。

## **3、AI 产业快速崛起，推动高多层板和 HDI 板市场快速扩容**

根据 IDC 发布的最新《全球人工智能支出指南》，2024 年中国政府在人工智能领域的支出规模为 25.5 亿美元，并以 25% 的增速持续领跑，成为 AI 应用的最大的下游市场。技术的升级与政务数字化需求的扩容，为 PCB 相关业务提供了广阔的增长空间。

近年来，在 AI 驱动下，全球算力基础设施快速扩张，AI 服务器、高性能计算与网络通信设备开启新一轮周期，叠加汽车电动化与智能化进程加速带来的量价齐增，高多层板和 HDI 板等 PCB 产品需求快速增长，行业整体景气度保持上行趋势。为适应下游领域的需求，PCB 正向着高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向发展，高多层板和 HDI 板等中高端 PCB 产品将保持强劲增长趋势。2029 年高多层板和 HDI 板的市场规模将分别达到 431.06 亿美元、212.95 亿美元，2024-2029 年的复合增长率分别为 9.0%、11.2%。

### **（二）本次发行的目的**

## 1、把握行业发展机遇，升级优化产品结构

近年来，AI、低空经济、机器人、新能源、光模块等新质生产力发展迅速，为 PCB 行业带来广泛的市场空间。尤其是 AI 快速重塑市场新格局，算力密度持续上升，数据传输速率从低速率向 400G、800G、1.6T 等高速率持续跃升，PCB 不再仅是传统的支撑与互联的“电子产品之母”，而以更高层数、更精密的结构、和更先进的材料融入产品核心，成为产品不可分割的重要组成部分，并从单一连接结构件升级为系统级结构件，技术与价值实现了双重提升。PCB 行业在 AI 算力基础建设的推动下，让 PCB 迎来了质价升级的价值重估。公司持续加大研发创新力度，已掌握高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜（铜厚 4oz~15oz）PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术，使得公司在行业快速发展时代下，能把握发展机遇。

相比于传统 PCB，以 AI 服务器与光模块应用为特色的高多层和 HDI 板技术难度高、工艺复杂、附加值高。公司拟通过本次募集资金投资加快进入高多层、高技术、高附加值市场速度，扩大经营规模的同时快速推动产品技术升级，在下游新兴领域持续开拓，产能快速释放的同时，通过加大布局高多层板和 HDI 产品规模，公司可实现产品结构升级优化和业务范围的持续扩展，抢占更多市场份额，增强公司市场竞争力，进一步夯实未来发展根基。

## 2、提升公司产能，满足不断增长的市场需求

根据 Prismark 的预测，未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长，尤其是 AI 领域市场规模以两位数的复合增长率快速发展，成为推动行业发展的重要动力。公司凭借成熟的产品体系、领先的行业地位和丰富的行业经验，正迎来更广阔的

市场空间，但公司现有中高端产能已难以支撑业务发展目标。

公司正处于产品结构升级和转型的关键时期，本次募投项目将新增高多层板和 HDI 板产能，通过购置大批量自动化生产的先进设备，巩固原有优势产品的同时，在服务器、光模块等高价值产品进行产线布局，突破公司在工业控制和汽车电子领域形成的以中小批量与高度柔性产线为特色的产能瓶颈，增强公司在服务器、光模块等领域的竞争力，实现公司业务转型升级和快速发展。同时本次产能的扩张有利于公司迅速抓住市场发展需求，进一步扩大公司市场份额，提升行业影响力。

本次募投项目主要投向下游景气度高、技术密集的市场增长领域，提升现有产能规模和供给弹性，以便更好承接下游市场快速发展和结构性增长的机遇，在现有服务器和光模块快速发展的基础上，打开更广阔的市场空间，为国内外客户提供更稳健的支撑，并为承接新兴优质客户奠定产能基础。

### **3、优化公司现有产品与客户结构，培育第二、第三增长曲线**

公司长期深耕工业控制与汽车电子，与日立、松下、欧姆龙、横河电机、安川电机等全球工控头部企业建立了稳固的合作关系，汽车电子领域也从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件渗透。依赖少数几个下游领域可能使公司增长受限，公司紧贴行业发展趋势与客户需求，巩固原有优势领域的同时，积极拓展以服务器与光模块为代表的新兴领域，提升高多层板和 HDI 板产能，是公司主动进行产品与客户结构优化、培育新增长点的战略需要。

从产品结构看，工控和传统汽车电子 PCB 对可靠性要求较高，但产品层数和技术复杂度低于服务器、光模块所用的高多层板和 HDI 板，其附加值、毛利率通常相对较低。公司工控和汽车电子领域客户分散，单一客户销售占比较低，不利于公司快速做大做强。通过募投项目增加高端产品的产能和销售规模，能够有效提升公司的整体盈利水平和抗风险能力，从而增强公司市场竞争力。

从客户结构看，进军服务器和光模块领域市场，公司将会与全球知名的云计算厂商、服务器品牌商、网络设备商以及芯片设计公司建立合作关系。这类客户

不仅订单规模大，且通常与供应商深度绑定，合作周期长，有利于公司建立长期稳定的合作关系和大客户战略的实施。公司募投项目的扩产是向“服务器+光模块”等新兴领域进行多元化扩张的关键一步，打造多领域布局、梯队式发展的增长格局。

#### **4、充实公司资金实力，助力公司快速发展**

公司所处行业为技术密集型和资金密集型行业，技术研发、生产运营均需大量资金投入，目前，公司正处于产品结构升级及转型的重要机遇期，随着 PCB 市场空间持续扩大，高端产品快速涌现，行业呈现典型的技术驱动特征。客观上促使行业参与者在技术创新与成果转化等方面加大投入，在巩固既有业务的同时，还需持续聚焦新技术突破、新产品落地及新市场拓展。为了抢占服务器、光模块等新兴领域市场，同时筑牢技术优势、抢抓发展机遇，亟需投入大量资金，公司资金面日益承压。

当前，全球 PCB 行业正处于市场需求与技术复杂度双重跃升的关键分水岭，为了满足未来业务发展需要，公司将不断加快服务器、光模块等新兴领域的拓展，进一步加大在技术研发、人才储备、生产设备、市场开发等方面的投入，增强公司市场竞争力。本次发行有利于公司补充发展资金，充实资金实力，推动公司发展战略进一步落地。

### **三、发行对象及其与公司的关系**

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的所有发行对象均以

现金方式认购本次向特定对象发行的股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

目前公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

## 四、本次发行方案概要

### （一）发行股票的种类、面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

### （三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

### （四）定价基准日

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股或资本公积转增股本等事项，公司将按照深交所的相关规则对前述发行底价作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$  为调整前发行底价， $P1$  为调整后发行底价， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送股或转增股本数。

本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

## （五）发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，按本预案出具之日的总股本计算即不得超过 48,156,349 股（含本数），最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册批复后，由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项或因其他原因导致本次发行前公

司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将根据深交所和中国证监会相关规定进行相应调整。

#### （六）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

#### （七）上市地点

本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易。

#### （八）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

### 五、募集资金投向

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 95,000.00 万元(含本数)，在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）	109,236.13	95,000.00
	合计	109,236.13	95,000.00

注：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元已从本次募集资金总额中扣减。

在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额投入募投项目，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 六、本次发行决议有效期

本次发行股东会决议的有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起 12 个月内有效。

## 七、本次发行是否构成关联交易

目前，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

## 八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具之日，发行人控股股东为四会明诚，持有公司 33.18%股份，为公司控股股东。刘天明、温一峰和黄志成以及四会明诚、天诚同创、一鸣投资共同签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，刘天明、温一峰和黄志成通过四会明诚、天诚同创、一鸣投资合计控制发行人 50.59%的股份；刘天明直接持有公司 2.31%的股份；温一峰直接持有公司 2.31%的股份；刘天明、温一峰和黄志成共同控制公司 55.21%的股份，为公司实际控制人。

本次发行不超过 48,156,349 股（含本数），按此上限测算，本次发行完成后四会明诚合计控制公司 25.52%的股份，实际控制人刘天明、温一峰和黄志成共同控制公司 42.47%，四会明诚仍为公司的控股股东，刘天明、温一峰和黄志成仍为公司共同实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

## 九、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行完成之后，公司社会公众股东合计持股比例将不低于公司总股本的 25%，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等法律法规规定的股票上市条件。本次发行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

## 十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序

### （一）已履行的审批程序

本次发行方案已经公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。

### （二）尚需履行的审批程序

根据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并获得中国证监会同意注册批复后方可实施。

在获得深交所审核通过及中国证监会注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行向特定对象发行股票的全部批准程序。

## 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 95,000.00 万元(含本数), 在扣除发行费用后将用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目(一期)	109,236.13	95,000.00
合计		<b>109,236.13</b>	<b>95,000.00</b>

注: 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求, 本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元已从本次募集资金总额中扣减。

在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额, 公司将根据实际募集资金净额投入募投项目, 募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的, 则届时将相应调整。

### 二、募集资金投资项目的具体情况

#### (一) 项目概况

本募投项目总投资 109,236.13 万元, 建设地点位于四会市龙甫镇惠源三路 1 号, 实施主体为本公司。本次募集资金到位后, 公司根据制定的募集资金投资计划具体实施。本项目通过引进先进的智能化生产设备, 新建配套的公用、辅助设施以及环保处理设施, 建成达产后将新增年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目。

## （二）项目实施的必要性

### 1、顺应高端 PCB 市场结构性高速增长的核心趋势，抢占未来增长主赛道

当前全球 PCB 产业正经历深刻的结构性变革，传统低端产品增长趋缓，而高端产品，特别是高多层板和 HDI，正成为驱动行业增长的核心引擎。对于公司而言，持续拓展高多层板和 HDI 板等高端产品是对公司未来增长曲线的战略性重塑，是其在新一轮产业升级中立足的关键举措。

从市场规模与增速看，高端 PCB 市场发展迅速。根据 Prismark 的数据，2025 年，高多层板和 HDI 板的产值分别实现了 18.2% 和 25.6% 的同比增长，是所有 PCB 细分产品中增长最快的领域，预计 2024-2029 年高多层板和 HDI 板复合增长率分别为 9.0% 和 11.2%。

从下游应用驱动力分析，增长动能强劲。AI 算力基础设施、高速网络通信、智能电动汽车等新质生产力领域正成为高端 PCB 需求快速增长的关键。以 AI 服务器为例，其 GPU 板组扩容、架构升级对 PCB 的层数、材料及工艺提出了更高要求，推动 PCB 向高密度化、高集成化方向演进。

### 2、突破技术壁垒，构建面向未来的核心竞争力与护城河

高多层板和 HDI 板，尤其是应用于服务器、光模块等领域的高端产品，其制造工艺复杂，是涉及材料学、精密加工、信号完整性设计等多学科交叉的复杂系统工程。继续拓展高多层板和 HDI 板等高端产品，推动公司技术能力完成质的飞跃，从而构建起公司的核心竞争力和护城河。

高多层板的技术挑战核心在于“高密度”与“高性能”的协同实现。随着层数向更高迈进，对 PCB 的层间对准度、阻抗一致性、散热性能及长期可靠性要求提高。HDI 板的技术壁垒则集中体现在“互连”和“高复杂度”上。HDI 通过使用微盲孔、埋孔来替代传统通孔，极大提升了单位面积的布线密度。高阶 HDI 的制造工艺需要循环重复“层压-激光钻孔-微孔电镀-线路”的工序，每增加一阶，良率控制的难度和成本都呈指数级上升，要持续开拓高端 HDI 市场，仍需在设备、工艺和人才上进行大规模、持续性的投入。本次募集资金是跨越这些关键的技术的资金保障，使公司从“具备能力”升级为“具备稳定、批量生产高端产品

的能力”，从而在价值链上占据更有利的位置。

### **3、把握 AI 算力爆发与硬件迭代的历史性机遇，切入高附加值客户供应链**

当前，以生成式人工智能为代表的科技革命正驱动全球算力基础设施快速扩张，不仅带来了量的增长，更引发了硬件架构的快速迭代，从而为上游 PCB 供应商创造了结构性的、高附加值的增量市场。公司持续拓展高多层板和 HDI 板业务，是为了完成从当前以工控、汽车电子为主的客户结构，向代表科技前沿的 AI 算力客户群延伸。

AI 服务器是高端 PCB 需求爆发的核心载体。一台 AI 服务器中，其 PCB 需求主要来自三个部分：（1）用于高密度互连的小型 AI 加速器模块（如 OAM），通常使用 4-5 阶 HDI；（2）通用基板（UBB），通常使用高多层板或 HDI；（3）传统的 CPU 主板，通常使用 4-6 层 PCB 板。根据 Prismark 数据，2023 年 AI/HPC 服务器的全球 PCB 市场规模接近 8 亿美元，预计到 2028 年将增长至 31.7 亿美元，2023-2028 年复合年增长率高达 32.5%，为 PCB 厂商提供了持续的订单和溢价空间。

公司要成为 AI 领域的核心供应商，需拥有规模化的高端产能和经过认证的稳定制程能力。公司当前的产能以满足样品和小批量需求为主，募投项目提升了公司生产大批量高多层板和 HDI 板的能力，是公司成为 AI 领域核心供应商的关键。

### **4、响应国家战略与产业政策导向，服务制造业高端化与自主可控大局**

公司募投项目高度契合国家推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的战略方向，符合增强产业链、供应链自主可控能力的政策诉求。

高多层板和 HDI 板是电子信息产业的基础核心部件，其技术水平直接关系到下游 5G 通信、人工智能、数据中心、新能源汽车、网络通信等战略性新兴产业的发展质量和安全。当前，全球高端 PCB 产能主要集中在中国台湾、日本、韩国等地区的少数厂商手中。中国大陆 PCB 产业虽规模全球第一，但在产品结构上仍以中低端为主，推动本土 PCB 企业向高多层、高阶 HDI 等高端领域突破，是中国实现电子信息产业自立自强的重要一环。

公司募投项目所生产的高多层板及 HDI 板产能，巩固现有优势产品的同时，将直接应用于服务器、智能终端、光模块等国家明确鼓励发展的重点领域，通过本土化供应，降低下游重点产业对海外供应链的依赖，有利于提升整个产业链的韧性和安全水平。从资本市场和长期发展的角度看，符合国家战略导向的产业投资，更容易获得包括政策支持、银行信贷、市场认可在内的多方面资源倾斜，为公司穿越周期、持续成长营造更有利的外部环境。

## **5、应对高昂的资本开支需求，为先进产能建设与设备升级提供资金保障**

高端 PCB 制造属于典型的技术密集型和资本密集型行业。从普通多层板向高多层、高阶 HDI 升级，需要新建或大规模改造厂房，并投入大量资金购置一系列专用生产设备，本次募集资金是应对这一资本开支的重要保障。

设备投资是高端 PCB 产能建设的最大支出项。以高多层板和 HDI 板为例，层数的增加、阶数的提升和材料的变化导致钻孔效率大幅降低，加工同样面积产品所需设备数量增加，且对高精度钻孔机需求提升。若仅依靠自身经营积累进行如此大规模的投资，将拖累公司现金流，错失市场快速发展的时间窗口。因此，通过资本市场进行股权融资，是平衡公司短期财务压力与长期战略投入、以最快速度搭建先进产能平台的最优选择。

### **（三）项目实施的可行性**

#### **1、深厚技术积累，为高端产能提供工艺支撑**

自成立以来，公司始终专注于高品质 PCB 的研发与生产，在技术领域形成了深厚的积累，这为其向更高层次的高多层板和 HDI 板业务拓展提供了坚实的技术支撑。

从研发体系与成果来看，公司已建立起成熟的创新机制，并获得了权威认可。公司是国家高新技术企业，获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术中心等认定，在高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。同时，公司形成了高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作

工艺研究与开发、厚铜（铜厚 4oz~15oz）PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术。截至本预案公告日，公司已经取得授权专利 35 项，其中发明专利 19 项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。

公司在泰国设立的生产基地已于 2024 年下半年开始逐渐投产，在技术上，公司攻克了高多层板和 HDI 板的核心制造工艺，掌握了从材料选型、图形转换、精密激光钻孔、层压对位、电镀填孔等一系列关键技术环节，能够满足光模块、服务器等对高可靠性、低阻抗的品质要求，已实现了高多层板与 HDI 板等产品的量产，为公司在国内建设更先进、更大规模的高端产能提供了宝贵的工艺参数、生产管理经验和人才储备和量产经验。

## **2、头部客户资源构成强大市场准入壁垒与客户转化基础**

公司长期专注于工业控制、汽车电子等高可靠性 PCB 市场，与全球顶级客户建立的长期信任关系，构成了公司进军高多层板和 HDI 板市场坚实的护城河和可行性保障。

首先，工业控制和汽车电子对 PCB 的长期可靠性、耐高温、耐振动、耐腐蚀以及低缺陷率要求严苛，公司在工控领域与头部企业松下、欧姆龙、安川电机、横河电机等知名客户建立了长期稳定的合作关系，在汽车电子领域从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件渗透，公司的质量管理体系、生产过程控制能力、品控能力已达到国际一流水平。服务器、光模块领域对 PCB 的可靠性和信号完整性要求极高，公司具备深厚高可靠性制造背景，产品品质更容易获得新开发领域客户的认可，客户信任建立更快。

其次，现有头部客户资源存在巨大纵向挖掘与横向拓展潜力。公司的客户结构优质，且正在持续多元化。一方面，其传统的日系头部客户本身也在进行产业

升级，其高端工控设备、机器人等产品对高多层板和 HDI 板的需求增长，公司可凭借长期合作建立的信任，优先获得老客户升级产品的订单，实现业务的自然延伸；另一方面，公司已成功开拓了服务器、光模块等领域的客户群，并获得了订单的高速增长。从工控、汽车电子的全球巨头，到服务器、光模块等领域的拓展，公司已构建了一个层次丰富、需求多元的优质客户池，这为新产能的消化提供了多层次的保障。

### **3、强大的人才队伍为项目实施提供保障**

公司在多年的经营发展中，形成了较稳定、专业且具有丰富行业经验的管理团队。公司董事长刘天明先生毕业于日本东京大学，有着十多年的日资 PCB 企业工作和管理经验，公司核心员工多年在 PCB 企业从事生产、技术、销售、管理，对电路板生产制造及品质管理理念有着深刻理解，熟悉客户的工作流程和管理风格，能够与客户进行积极有效沟通。公司人员结构稳定，本地员工占 70% 以上，为本地员工提供有竞争力的薪酬；公司还通过股权激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感，为持续稳定生产高品质的 PCB 提供保证。

### **4、下游 AI 算力与汽车电子需求爆发，为新增产能提供了订单空间**

高多层板和 HDI 板的下游需求正经历由 AI 算力和汽车智能化驱动的结构爆发，为公司的新增产能提供了订单保障。

首先，AI 服务器对高端 PCB 的需求呈指数级增长，且其技术迭代快、产品附加值高，生成式 AI 的浪潮推动全球算力基础设施疯狂扩张。AI 服务器刺激 PCB 的需求爆发式增长，据广东省电路板行业协会数据，每一台 AI 服务器的 PCB 产值较传统服务器提升 5~7 倍，根据 Prismark 预测，2023-2028 年 AI 服务器相关 HDI 板的年均复合增速为 16.3%。公司光模块板产品技术能力得到市场前沿客户的认可，已获得客户批量订单，AI 服务器领域订单增长迅速，为新增产能消化提供保障。

其次，汽车智能化与电动化推动车用 PCB 市场量价齐升，高阶 HDI 渗透率快速提高。汽车电子领域是公司传统优势领域，这一领域正在发生深刻变革，新能源汽车的电子元件是传统燃油车的 3-4 倍，三电系统（电池、电机、电控）需

要大量高可靠性 PCB，智能驾驶和智能座舱对数据处理能力要求飙升，推动车用 PCB 向高层数、高密度发展。公司已从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件，具备了供应车规级高阶产品的基础。随着客户车型的迭代升级，对高阶 HDI 和高多层板的需求将会向公司释放，保障新增产能相当一部分可以被汽车电子业务消化。

### **第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

#### **一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况**

##### **（一）本次发行对公司业务及资产的影响**

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金均用于公司主营业务，项目实施后，公司的业务范围不会发生重大变化，不涉及公司业务与资产的整合，但将丰富公司产品线，丰富产业生态，增强业务竞争力。

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，资本实力和抗风险能力将得到提升，符合公司及全体股东的利益。

##### **（二）本次发行对公司章程的影响**

本次发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中的与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

##### **（三）本次发行对股东结构的影响**

本次发行完成后，公司股本将增加，原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司控股股东、实际控制人仍保持不变。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

本次发行完成后，不会导致公司股权分布不具备在深交所的上市条件。

##### **（四）本次发行对高级管理人员结构的影响**

本次发行完成后，公司预计不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员

结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（五）本次发行对业务结构的影响**

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，相关项目实施完成后带来的收入仍为公司原有主营业务收入。公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

## **二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况**

#### **（一）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司净资产及总资产规模将相应增加，资金实力将明显提升，风险抵抗能力进一步增强，为后续业务扩展提供良好的保障。

#### **（二）本次发行对公司盈利能力的影响**

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，资本规模进一步扩大。本次募集资金均投向公司主营业务，用于公司未来发展的战略布局。但由于公司募投项目的建设 and 生产需要一定时间，募投项目效益在短时间内无法完全体现，因此本次向特定对象发行完成后，短时间内发行人的净资产收益率及每股收益指标将被摊薄。

从长远来看，本次募集资金投资项目的实施将对公司主营业务的发展产生积极影响，有利于提升公司的综合竞争力，随着募集资金投资项目预期效益的实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

#### **（三）本次发行对公司现金流量的影响**

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入将大幅增加，同时随着募投项目的建设，公司投资活动现金流出也将相应增加。待公司募投项目投入运营并产生效益后，公司的竞争实力不断提升，将有助于扩大公司经营活动现金流入规模。

## **三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理**

## 关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争不会因本次发行而发生重大变化。本次向特定对象发行也不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

## 四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本预案公告日，本公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

本次发行不会导致公司资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不会产生公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

## 五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将增加，资产负债率会随之下降，财务结构将进一步优化，抗风险能力将进一步增强，实现长期可持续发展。

## 第四节 本次股票发行相关的风险说明

### 一、与本次向特定对象发行的相关风险

#### （一）本次发行的审批风险

本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得上述批准的时间存在不确定性。

#### （二）发行风险

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，且最终根据竞

价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，发行价格不低于定价基准日（即发行期首日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十。本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

### （三）股价波动风险

股票市场投资既包含潜在收益，也伴随一定风险。公司股票价格的波动不仅取决于自身盈利水平和发展前景，还受到宏观经济政策调整、金融政策调控、市场供需变化、投资者情绪及市场投机行为等多种因素的影响。这些因素可能导致股价波动，从而给投资者带来一定风险。

此外，本次向特定对象发行股票需经过相关监管部门的审批，审批流程存在一定周期。在此期间，公司股票市场价格可能因市场环境变化或投资者预期调整而产生波动，增加投资者的不确定性风险。

## 二、募集资金运用的风险

### （一）募集资金投资项目实施风险

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素，经过慎重、充分的可行性研究论证后做出的，但由于募投项目的实施需要一定时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟实施等不确定性事项，也会对募集资金投资项目的实施效果和预期效益带来较大影响。

### （二）即期回报被摊薄的风险

本次发行的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量有所提高，募集资金投资项目释放经济效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。若募集资金使用效益短期内难以全部实现，或公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长

幅度，公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

### **（三）新增产能消化风险**

本次募集资金投资项目实施完成后，公司 PCB 的产能将明显提升，但项目建设周期较长，如果未来市场需求、行业竞争格局等发生重大不利变化，公司未能采取及时有效的应对措施，则公司将面临募投项目新增产能无法消化的风险。

## **三、行业及市场风险**

### **（一）宏观经济波动风险**

公司主营业务为各类印制电路板的研发、生产与销售业务，印制电路板作为电子元器件基础行业，PCB 行业的发展与电子信息产业及宏观经济形势密切相关，尤其是随着电子信息产业国际化程度的提高，PCB 需求受全球市场环境影响较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业如工业控制、汽车电子、服务器、通信设备、医疗器械、光模块等等于将产生不同程度的影响，进而影响 PCB 行业的需求增长。如果未来全球地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头以及下游行业出现周期性波动，或国家财政、货币、贸易等宏观政策发生不利调整，可能对公司经营业绩产生一定影响。

### **（二）行业产能大幅扩张导致产品价格下降的风险**

近年来，全球 PCB 产能不断向国内聚集，我国已成为全球印刷线路板的主要生产基地。近几年国内 PCB 产能仍处于快速扩张态势，若未来出现行业产能过剩、行业竞争加剧导致产品价格下滑，公司未能持续提高公司的技术水平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，则存在盈利下滑的风险。

### **（三）市场竞争风险**

PCB 行业竞争激烈，行业格局正朝着“大型化、集中化”方向发展。行业龙头企业通过技术创新、规模扩张及供应链整合不断增强市场影响力，而中小企业则面临更大生存压力。若公司未能及时把握市场机遇，持续进行资金投入及技术研发，快速适应产品开发和市场策略的变化，可能会在市场竞争中失去优势，出现订单下滑、收入利润下降进而导致市场份额缩减的风险。

## 四、业务经营风险

### （一）原材料供应紧张及价格波动风险

公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、金盐、半固化片、铜箔等，主要原材料价格受国际市场铜、金等大宗商品的影响较大。若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

### （二）管理风险

本次募集资金投资项目实施后，公司将进一步拓展经营业务，形成更加良好的经营局面，这对公司管理团队的能力提出了更高要求。公司将在战略规划、制度建设、组织架构、运营管理、资金管理以及内部控制等多个方面面临更为复杂和严峻的挑战。如果公司未能高效且高质量地执行发展战略，导致运营能力与实际业务布局需求不匹配，可能影响公司整体运营效率与市场竞争力。

### （三）汇率波动风险

汇率波动对公司的影响主要体现在：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。

报告期，公司出口销售收入占主营业务收入的比例较大。若未来人民币出现大幅升值，一方面会导致公司汇兑损失增加，另一方面相对国外竞争对手的价格优势可能被减弱，假设在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，可能对公司经营业绩造成不利影响。

### （四）人工成本上升的风险

随着公司业务规模扩张，尤其在产能提升及市场需求增长的背景下，公司对劳动力的需求持续增加。若用工成本大幅上升，而公司未能通过自动化生产技术优化人力需求或提升生产效率，可能对成本结构和盈利能力产生不利影响。在全

球劳动力成本上升及行业竞争加剧的情况下，较高的用工成本可能进一步压缩公司利润空间，影响持续盈利能力和市场竞争力。

#### **（五）固定资产折旧增加的风险**

本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产较本次发行前有所增加，由此带来每年固定资产折旧的增长。虽然本次募集资金投资项目建成后，公司扣除上述折旧费用的预计净利润增长幅度超过折旧费用的增长幅度，但若募集资金投资项目达产后，国家政策发生重大调整或市场环境发生较大变化，募集资金投资项目收益不达预期，募投项目建成后折旧费用的增加仍可能在短期内影响公司收益的增长。

## **第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况**

### **一、公司现行的利润分配政策**

根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：

#### **（一）利润分配的原则**

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定公司的利润分配方案。

#### **（二）利润分配的形式**

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的方式。

#### **（三）利润分配的决策程序及机制**

1、公司利润分配政策应由公司董事会向公司股东会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，且经公司二分之一以上独立董事表决通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并

直接提交董事会审议。

2、公司利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司利润分配政策提交公司股东会审议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股股东方便参与股东会表决提供服务。

#### （四）现金分红的条件及时间、比例

##### 1、现金分红的条件

（1）如公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）无重大投资计划或重大资金支出发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟购买重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，或者超过 2 亿元人民币。

##### 2、现金分红的时间及比例

在符合利润分配原则、在满足正常生产经营的资金需求情况下，保障公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，也可拟订年度利润分配预案时就下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等提出建议方案，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

#### **(五) 股票股利分配条件**

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

#### **(六) 利润分配政策的调整机制**

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。

#### **(七) 利润分配信息披露机制**

公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的

合法权益是否得到充分维护等。

## 二、公司最近三年现金分红情况

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年累计现金分红（含回购股份注销）金额占最近三年年均可分配利润的比例为 70.13%，报告期内，发行人的分红政策由董事会、股东会审议通过，履行了相应的决策程序，发行人历年分红执行情况符合发行人《公司章程》规定及相关政策要求。

## 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为完善和健全四会富仕电子科技股份有限公司稳定、持续的利润分配决策程序和监督机制，积极回报股东并引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，切实保护中小股东的合法权益，公司特制定《四会富仕电子科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

### （一）本规划的制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，着眼于公司的长远和可持续发展。

### （二）制定本规划考虑的因素

本规划结合公司利润状况和生产经营发展实际需要，充分考虑对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

### （三）未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划

#### 1、利润分配形式

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的方式。

## 2、现金分红的条件及时间、比例

### (1) 现金分红的条件

①如公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④无重大投资计划或重大资金支出发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟购买重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或者超过2亿元人民币。

### (2) 现金分红的时间及比例

在符合利润分配原则、在满足正常生产经营的资金需求情况下，保障公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，也可拟订年度利润分配预案时就下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等提出建议方案，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

### （3）股票股利分配条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

### （四）利润分配的决策程序与机制

（1）公司利润分配政策应由公司董事会向公司股东会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，且经公司二分之一以上独立董事表决通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）公司利润分配政策应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司利润分配政策提交公司股东会审议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股股东方便参与股东会表决提供服务。

### （五）股东回报规划的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。

### （六）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红

政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

## **第六节 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺**

### **一、本次发行对公司主要财务指标的影响**

#### **(一) 主要测算假设及前提条件**

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2026 年 11 月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准；

3、根据公司已披露的《四会富仕电子科技股份有限公司 2025 年度报告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润及 2025 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 12,812.28 万元及 11,338.60 万元；

4、假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2025 年度的基础上考虑上升 15%、持平、下降 15%三种情形。该假设仅用于计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

5、假设 2026 年不进行利润分配；

6、在预测公司总股本及相关指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化。截至本次董事会会议召开日，公司总股本为 160,521,165 股，假

设本次发行的股票数量为发行上限，即发行股票数量为 48,156,349 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将达到 208,677,514 股；

7、本次测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；

8、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算本次向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标的影响，具体测算情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	发行前（2026 年度 /2026 年 12 月 31 日） （预测）	发行后（2026 年度 /2026 年 12 月 31 日） （预测）
总股本（万股）	16,052.12	16,052.12	20,867.75
<b>情形 1、假设 2026 年公司净利润较 2025 年上升 15%</b>			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,812.28	14,734.12	14,734.12
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,338.60	13,039.39	13,039.39
基本每股收益（元/股）	0.88	0.92	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.92	0.90
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.78	0.81	0.79
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.78	0.81	0.79
<b>情形 2、假设 2026 年公司净利润较 2025 年持平</b>			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,812.28	12,812.28	12,812.28
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,338.60	11,338.60	11,338.60
基本每股收益（元/股）	0.88	0.80	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.80	0.78
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.78	0.71	0.69
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.78	0.71	0.69
<b>情形 3、假设 2026 年公司净利润较 2025 年下降 15%</b>			

归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,812.28	10,890.44	10,890.44
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,338.60	9,637.81	9,637.81
基本每股收益（元/股）	0.88	0.68	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.68	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.78	0.60	0.59
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.78	0.60	0.59

注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

## 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量有所提高，募集资金投资项目释放经济效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。若募集资金使用效益短期内难以全部实现，或公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

公司对相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公司对经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。此外，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。

## 三、本次发行的必要性和合理性

关于本次向特定对象发行A股股票的必要性和合理性，请参见本预案之：“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

## 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

### （一）本次募投资金投资项目与公司现有业务的关系

公司专注于 PCB 主业，持续推进高端产能扩建，并通过技术创新和智能化升级，保持核心业务的稳步增长。公司本次向特定对象发行募集资金投资的项目系围绕公司主营业务开展，是公司业务发展、产业升级的现实需求，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向。

通过本次募集资金投资项目的实施，围绕公司核心业务布局，重点扩产高多层板和 HDI 板等高端产能，项目将通过引入智能化设备、优化生产工艺、突破关键技术瓶颈，满足工控、汽车电子产能需求的同时，突破服务器、光模块等前沿应用领域对高端 PCB 的需求，有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，同时有助于充实公司资本实力，优化公司财务结构，提高抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

## **（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

### **1、人员储备**

自公司成立以来，一直将人才团队的建设与培养视为公司主要的发展目标之一。在人员储备方面，公司拥有一批专业知识扎实、自主研发创新能力强、实战经验丰富的专业研发人才团队，核心技术人员均为印制电路板行业的资深专家，具有长期、丰富的生产及技术研究开发经验。同时公司已经形成了一套成熟的管理制度与研发制度，组建了一支多层次、专业性强、经验丰富的管理团队和研发团队。且公司地处珠三角一隅，员工主要以本地为主，稳定度强，流失率低，人才储备充足，有助于公司实现高效稳定的管理，顺利应对市场环境变化，保持持续、稳定的创新能力，为本次募集资金项目的顺利实施提供了重要保障。

且公司各部门将按照本次募集资金投资项目的实施计划，对所需的专业人员进行提前规划，使得募集资金投资项目拥有充足且专门的人力储备。同时，针对募集资金投资项目所需要的新技术，公司也将加强相关人员的培训工作，确保相关人员能够胜任相关工作。

### **2、技术储备**

公司是国家高新技术企业，获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术

中心等荣誉称号。

公司作为国内领先的印制电路板制造商，长期以来，一直坚持技术驱动市场发展战略，紧密关注行业的核心技术发展动态，及时获取前沿技术信息，在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性。且公司的主要客户均为世界知名行业领先企业，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变化信息，也可及时掌握客户需求的变化及当下最前沿的产品标准及技术情况并进行对应的技术前期开发。

经过公司研发团队长期自主研发，公司已相继开发高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜（铜厚 4oz~15oz）PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术，截至本预案公告日，公司已经取得授权专利 35 项，其中发明专利 19 项，通过这些技术的运用，公司可向工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械、新能源、光模块、AI 服务器等高可靠性要求的产品领域提供相应产品，满足不同客户的需求。未来公司还将进一步加大研发相关的投入，提高相关新技术的产出能力、相关技术人才的管理能力，为本次募投项目的顺利实施提供强有力的技术保障。

### 3、市场储备

公司深耕行业多年，始终以客户为中心，凭借优质的产品质量、长期稳定的高效生产能力以及快速响应客户的服务，与下游相关行业的多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司主要客户为国内外上市公司及知名 EMS 企业，包括日立、松下、欧姆龙、安川电机、ABB、ROCKWELL 等全球知名客户。同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，与重点客户已合作多年，业务关系

稳定，多次获得客户颁发的产品质量奖项，包括欧姆龙（OMRON）的集团质量体系认证、岛津（SHIMADZU）、山洋电气（SANYODENKI）、安川电机（YASKAWA）的优秀供应商奖。同时公司已成功开拓了服务器、光模块等领域的客户群，并获得了订单的高速增长。从工控、汽车电子的全球巨头，到服务器、光模块领域的拓展，公司已构建了一个层次丰富、需求多元的优质客户池，丰富且优质的客户资源及稳定的客户合作关系将为本次募投项目的建设及投产奠定良好的市场基础。

综上，公司在人员、技术和市场等方面具备丰富的储备，能够为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

## 五、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施

### （一）大力推进募投项目建设，增强公司盈利能力

公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

### （二）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》并将依此严格管理募集资金。同时，公司将合理安排项目投资进度，提升募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设以如期实现本次募投项目的投产，尽早产生效益以回报公司股东。

### （三）优化投资回报机制

为了积极回报投资者、保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已制定《四会富仕电子科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。同时公司也建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制等。届时，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者的

相关合法权益，有效维护和增加对投资者的回报。

#### **（四）进一步加强经营管理和内部控制，为公司发展提供保障**

本次发行完成后，公司的业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化，公司的抗风险能力及核心竞争力也将得到进一步增强。

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，不断加强公司经营管理，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司长期稳定的发展提供坚实的制度保障。

上述填补回报措施不等于对公司未来的利润情况做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担相关赔偿责任，敬请广大投资者注意相关的投资风险。

## **六、相关主体关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

### **（一）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺**

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东四会市明诚贸易有限公司，实际控制人刘天明、温一峰、黄志成承诺如下：

- 1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，；
- 2、本承诺出具后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求且上述承诺不再满足相关规定的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- 3、本公司/本人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行

前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意根据相关法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。

## **(二) 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺**

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求且上述承诺不再满足相关规定的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。

四会富仕电子科技有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日